2024 年 12 月 4 日

一般社団法人エポキシ樹脂技術協会
研　究　委　員　会

第 3 期第 1 回特別講演会開催の御案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、一般社団法人エポキシ樹脂技術協会　第 2 期第 4 回特別講演会を下記の通り、対面形式にて開催致します。奮ってご参加頂きたく御案内申し上げます。

敬 具

記

日　　時 ：２０２５年１月２７日(月)　　午後２時から午後４時迄

場　　所 ：ＤＩＣ株式会社　本社　会議室

（住所：東京都中央区日本橋 3－7　ディーアイシービル　案内図をご覧ください。）

講 演 題 名 ：５Ｇ通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発

講 演 概 要 ：エポキシ樹脂組成物では、達成困難と考えられていた高周波対応プリント基板への適用に成功し，５Ｇ通信の普及を加速させた活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の分子設計について述べる。

講　　師　：ＤＩＣ株式会社　　Ｒ＆Ｄ統括本部
シニアサイエンティスト　　工学博士　有田　和郎　氏

参 加 資 格 ： 会員何名にても可（無料）　非会員のかたは聴講料 10,000 円です。
(非会員のかたには請求書を送付いたしますので、それに従い聴講料をお支払い願います)

出 席 申 込 ： 添付の書式又はこれに準じたもの(社名／機関名、所属、氏名、E-mail 、電話番号、FAX 番号明記)にて E-mail あるいは FAX にてお申込下さい。

以上

＜案内図＞

DIC 株式会社　本社　会議室
東京都中央区日本橋３－７　ディーアイシービル
TEL　03－6733―3000

２０２５年　月　　日

特別講演会出席申込み

一般社団法人エポキシ樹脂技術協会御中
(E-mail: jsertadm@epoxygk.jp
FAX 番号：03－3235－9012)

社名／機関名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所　属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
氏　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
E-mail:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
FAX 番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

一般社団法人エポキシ樹脂技術協会主催の下記第３期第１回特別講演会に出席を申し込みます。

記

日　　時　：２０２５年１月２７日(月)　　午後２時から午後４時迄
場　　所　：ＤＩＣ株式会社　本社　会議室
（住所：東京都中央区日本橋３−７　ディーアイシービル　案内図をご覧ください。）
講 演 題 名　：　５Ｇ通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発
講　　師　：　ＤＩＣ株式会社　　Ｒ＆Ｄ統括本部
シニアサイエンティスト　　工学博士　有田　和郎　氏

以 上

－－－

〔 返 信 欄 〕
これより下の欄は当会にて記入します。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

上記特別講演会への出席申込書を受領いたしました。当日はよろしくお願いいたします。

事務局発信日